

证券代码：688130

证券简称：晶华微

公告编号：2025-038

杭州晶华微电子股份有限公司

关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“晶华微”）于 2025 年 7 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司深圳晶华智芯微电子有限公司（以下简称“晶华智芯”）提供不超过 3,500 万元的借款以实施募投项目“研发中心建设项目”。该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项发表了同意的意见。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州晶华微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1203 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股 1,664 万股，每股发行价格为人民币 62.98 元，募集资金总额为 1,047,987,200.00 元；减除发行费用 127,450,183.35 元后，募集资金净额为 920,537,016.65 元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 7 月 26 日出具了验资报告（天健验〔2022〕385 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募投项目的基本情况调整情况

根据公司披露的《杭州晶华微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司于 2025 年 7 月 10 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2025 年 7 月 29 日召开了公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《关于募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点的议案》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	总投资额	原计划投入募集资金	调整后投入募集资金	实施主体
1	智慧健康医疗 ASSP 芯片升级及产业化项目	21,089.00	21,089.00	21,089.00	杭州晶华微电子股份有限公司
2	工控仪表芯片升级及产业化项目	19,069.00	19,069.00	19,069.00	杭州晶华微电子股份有限公司
3	高精度 PGA/ADC 等模拟信号链芯片升级及产业化项目	17,519.00	17,519.00	终止实施。截至 2025 年 5 月 31 日，项目实际投入募集资金 3,149.81 万元，公司将剩余募集资金继续存放募集资金专户并寻找新项目	杭州晶华微电子股份有限公司
4	研发中心建设项目	12,323.00	12,323.00	12,323.00	杭州晶华微电子股份有限公司，深圳晶华智芯微电子有限公司
5	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	杭州晶华微电子股份有限公司
	合计	75,000.00	75,000.00	75,000.00	-

注：调整后，“智慧健康医疗 ASSP 芯片升级及产业化项目”“工控仪表芯片升级及产业化项目”“研发中心建设项目”实施期限延长至 2027 年 7 月，“高精度 PGA/ADC 等模拟信号链芯片升级及产业化项目”终止实施，“研发中心建设项目”增加实施主体全资子公司深圳晶华智芯微电子有限公司，增加实施内容智能家电控制芯片的开发设计研究。

三、本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款的情况

根据审议通过的《关于募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点的议案》，公司“研发中心建设项目”增加全资子公司晶华智芯为实施主体，为确保该募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金使用效率和项目实施进度，公司拟使用部分募集资金向晶华智芯提供总额不超过 3,500 万元的借款。

公司将根据募投项目的建设进展及实际资金需求，在借款总额度内分批次划

转至晶华智芯开立的募集资金专户。借款利率参照每笔借款的借款日（提款日）前一工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）确定。借款期限自实际借款之日起计算，每笔借款期限自实际借款之日起不超过 2 年，晶华智芯可根据自有资金及项目实施情况提前偿还或到期续借。本次公司提供的借款将存放于晶华智芯开立的募集资金存储专用账户进行管理，仅限用于上述募投项目的实施建设，不得用作其他用途。公司董事会授权管理层办理上述借款具体事宜，包括但不限于签署相关协议等。

四、本次借款对象的基本情况

- 1、名称：深圳晶华智芯微电子有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300MADYFLKY6H
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、法定代表人：纪臻
- 5、注册资本：3300 万元人民币
- 6、成立日期：2024 年 09 月 11 日
- 7、住所：深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件园（2 期）12 栋 601
- 8、经营范围：一般经营项目：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；集成电路芯片及产品制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目：无。
- 9、股权结构：公司持有晶华智芯 100%股权
- 10、信用状况：不属于失信被执行人
- 11、是否存在影响偿债能力的重大或有事项：否
- 12、与公司的关联关系：公司全资子公司
- 13、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

财务情况	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (经审计)	2025 年 3 月 31 日/2025 年第一 季度 (未经审计)
资产总额	4,353.70	5,251.15

负债总额	1,105.22	1,969.53
资产净额	3,248.48	3,281.62
营业收入	1,110.20	890.42
净利润	-51.52	33.13
扣除非经常性损益后的净利润	-70.74	32.94

注：上述 2024 年 12 月 31 日/2024 年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

五、本次提供借款的目的及对公司的影响

公司本次使用部分募集资金向全资子公司晶华智芯提供借款，是为满足募投项目实施需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和安排，符合公司整体战略规划和长远利益，不会对项目实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。公司本次提供借款的对象为公司全资子公司，向其提供借款期间公司对其经营管理活动具有控制权，财务风险可控。

六、本次提供借款后募集资金的管理

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，本次借款到账后将存放于募集资金专用账户中，晶华智芯将设立募集资金专户，公司、晶华智芯将与国泰海通及募集资金专户监管银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件的要求规范使用募集资金，对募集资金使用实施有效监管，同时严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

七、公司履行的审议程序

公司于 2025 年 7 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司晶华智芯提供不超过 3,500 万元的借款以实施募投项目“研发中心建设项目”。该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

八、保荐机构专项核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目是基于公司实施募投项目的具体需要，符合公司募集资金使用计划，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金使用计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。

综上，保荐机构对公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项无异议。

特此公告。

杭州晶华微电子股份有限公司

董事会

2025年7月30日